

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
会议时间	2026年1月27日
会议地点	现场调研+电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事长：HUI WANG 财务负责人：LISA YI LU FENG 董事会秘书：罗明珠
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>● 问答环节</p> <p>1、从公司1月23日披露的公告来看，2025年Q4营收环比Q3有所下滑，请问具体是什么原因？</p> <p>答：上述数据存在一定变动主要有以下两个原因：（1）原定于2025年Q4交货的设备或将延后至2026年Q1交货。（2）2025年部分销售将在2026年Q1确认。</p> <p>2、盛美上海和美国ACMR在2026年营收指引中数据有一定差异的原因是什么？</p> <p>答：盛美上海和美国ACMR财报数据出现差异的原因是会计准则不一样。对于盛美上海，公司的收入确认时点是在测试验收之后，通常是在设备发出并调试验收后才确认收入。对于控股股东美国ACMR，根据其适用的美国会计准则，对于首台设备订单，需要在</p>

设备测试验收以后才确认收入；对于此前已存在交易的重复设备订单，在发货后即可确认收入。

3、可以简单介绍下逻辑客户和存储客户的情况吗？哪部分客户比较多？客户的采购份额情况如何？

答：整体来看，存储客户占比略高于逻辑客户，整体差异不大，逻辑客户增长也很强劲。具体客户的采购份额会有所差异，部分客户采购公司产品比例达到了 50%以上。2026 年，公司期待实现清洗设备的种类全覆盖、工艺全覆盖，积极推进成熟工艺继续扩大市场，在先进工艺上也将持续提升市场占有率。

4、请问公司预计 2026 年的毛利率水平和研发投入占比如何，会有什么变动吗？

答：公司预计 2026 年的毛利率水平仍将保持在 42%-48%之间，研发投入占比预计将在 14%-19%之间。

5、请问公司预计今年市场竞争是否会加剧？尤其是在清洗设备方面，对此公司有何应对？

答：清洗设备的市场竞争一直存在，但公司高度重视技术差异化，持续推进产品创新与技术突破，相关创新技术也同步申请了专利保护，公司的核心技术本身是无法复制的。同时，公司坚持长期稳健的研发投入，为技术创新提供强劲支撑，有效巩固了公司的核心竞争力。

6、请问公司的海外客户及产品拓展情况如何？

答：公司高度重视海外市场的拓展，始终坚持“技术差异化、产品平台化、客户全球化”的发展战略，产品矩阵已覆盖清洗设备、电镀设备、先进封装湿法设备、立式炉管系列设备、涂胶显影设备、PECVD 设备和面板级设备等，且所有设备均拥有全球自主知

识产权、具备差异化的市场竞争优势，持续提升了国际市场的客户认可度。目前，公司自主研发的差异化核心设备已获得多家国际客户的关注与认可，今年公司已经有产品进入新加坡市场，去年也有四台设备进入美国市场，同时也在推进中国台湾、韩国等海外市场的扩张，预计 2026 年海外市场开拓速度相对 2025 年会加速。未来公司将持续推进客户全球化战略，积极推进产品出海，扩大海外市场销售份额，不断将具有差异化竞争优势的产品更多推向海外市场，为整体营收攀升提供支撑，更为全球半导体的工业发展贡献力量。

7、公司的面板级封装设备今年是否会在中国台湾市场取得客户突破，目前推进进展如何？

答：目前，公司重点推出的面板级先进封装的新设备包括 Ultra ECP ap-p 面板级电镀设备、Ultra C vac-p 面板级负压清洗设备和 Ultra C bev-p 面板级边缘刻蚀设备等三款新产品。其中，Ultra ECP ap-p 面板级电镀设备创新性地采用了专利申请保护的平面（水平）电镀方式，让方形电场与面板实现同步旋转，能够更好地控制电镀均匀性；同时能够实现面板传输过程中引起的槽体间污染控制，大大降低了不同种金属电镀槽之间化学交叉污染的风险；Ultra C vac-p 面板级负压清洗设备利用负压技术去除芯片结构中的助焊剂残留物，可使清洗液到达狭窄的缝隙，显著提高了清洗效率，目前该设备已经在客户端实现量产；Ultra C bev-p 面板级边缘刻蚀设备采用专为边缘刻蚀和铜残留清除而设计的湿法刻蚀工艺，在扇出型面板级封装技术中起到至关重要的作用。

公司将积极推进上述三类产品在中国台湾市场的应用及拓展，后续相关产品的具体动态信息敬请关注公司披露的公开信息。公司将积极把握面板级设备市场发展趋势，做全湿法工艺的面板设备类型。此外，晶圆级封装设备今年也有信心在中国台湾打开市场。

8、出于地缘政治等外部环境不确定性因素考量，公司是否会进行海外生产布局？

答：公司从 2017 年就开始进行相关布局，在海外已设有韩国研发与生产基地，可实现多元化海外供货，更好满足客户的多样化需求。未来，公司将在海外市场持续推进本地化布局，降低关税等外部因素冲击，提升盈利能力。

9、2025 年度，公司先进封装设备及电镀设备分别占总营收的比重如何？公司预计 2026 年先进封装设备的情况如何？

答：2025 年度，粗略估计，公司先进封装（不含电镀）设备产品收入占总营收的比例接近 10%，电镀设备约占总营收的比例超过 20%。先进封装设备市场具有广阔市场发展前景，目前整体行业发展趋势向好，在中国市场的成长潜力较大，公司期待先进封装设备成为 2026 年业绩增长的一个关键业务板块。

10、请问公司如何展望 Track、PECVD 及 LPCVD 等产品设备未来的表现？

答：2025 年，公司立式炉管、Track 以及 PECVD 设备等平台化产品已陆续投放市场，有望为 2026 年及今后的整体营收贡献力量，成为重要的业绩增长点。

Track 设备方面，2025 年第三季度公司推出首款自主研发的高产出（300WPH）KrF 工艺前道涂胶显影（Track）设备 Ultra LITH KrF，并已顺利交付中国头部逻辑晶圆厂客户，该产品具有高产能、先进温控技术以及实时工艺控制和监测功能，进一步拓展了光刻相关的应用领域，展现了公司在新产品品类中的持续扩展能力。

在 PECVD 设备方面，公司对该类设备的差异化技术构架及未来市场前景非常有信心，后续也将持续加大研发投入，将 PECVD 设备

推向更广阔的国内外市场。

LPCVD、ALD 炉管系列设备持续推进技术研发，均取得了创新突破。公司自主研发的 Ultra Fn 立式炉管设备采用公司独有的立式炉管结构设计，具备最高 1250° C 的处理能力，能够聚焦高端 IGBT 应用，市场整体反响良好，下一代产品目标做到具备 1350° C 的处理能力，对 IGBT 是重大利好；在 ALD 设备方面，近年来公司持续强化对 ALD 设备的研发投入，积累了一系列自主研发的具有全球知识产权保护的专利技术，并期待未来能够在 ALD 设备均匀性、材质等方面持续做出更多贡献，取得更多技术突破，以差异化创新工艺持续满足客户多样化需求，将成为公司未来业绩增长的一大增长点。

11、去年第三季度公司毛利率有所承压，从去年第四季度至今年一季度的出货结构来看，请问公司毛利率是否存在改善趋势？

答：去年第三季度盛美上海整体波动不大、ACMR 毛利率有所降低，主要是受中国和美国会计准则差异化要求影响。公司将持续推动技术迭代与产品创新，不断解决客户端的工艺难题，巩固差异化竞争壁垒，从而促进毛利率保持稳健向好趋势。

附：参与单位名称

Aberdeen Group

Amber Capital

J. P. Morgan

安捷资产管理有限公司

博时基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

宏利基金管理有限公司

华宝基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

金鹰基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

深圳景泰利丰投资发展有限公司

深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司

武汉美阳投资管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

招商基金管理有限公司

中信证券股份有限公司

中银基金管理有限公司

中邮证券有限责任公司